

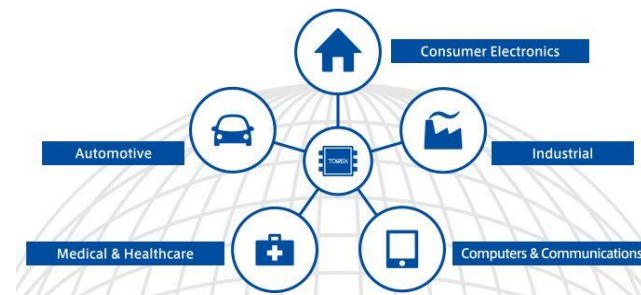
2023年3月期 通期 決算説明資料

2023年5月18日

トレックス・セミコンダクター株式会社

世界は「アナログ」でできている

あらゆるフィールドで活躍するトレックスの電源IC



1

2023年3月期 通期業績

2

2024年3月期 業績予想

3

トピックス

4

株主還元

Appendix

2023年3月期 通期業績



トレックスは、通期では上場来最高の売上・営業利益を計上。下期は在庫調整の影響を受け減速



フェニテックは、売上は通期で上場来最高を記録するも、電力料などの原価が増加し、減益



対業績予想は、想定を上回る売上の減少により売上・営業利益ともに未達

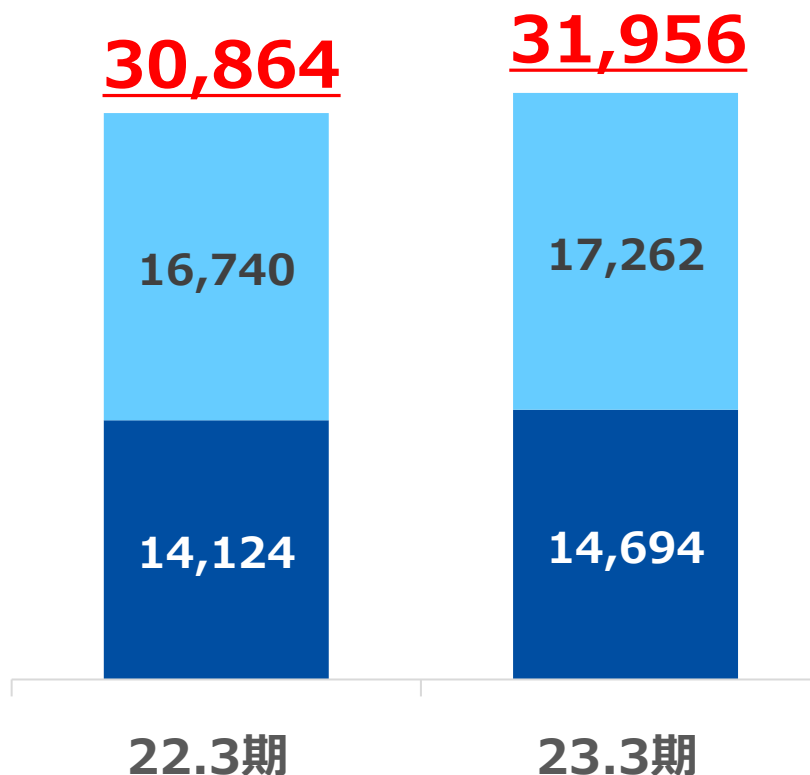
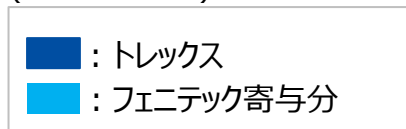
また、鹿児島工場減損の影響により当期純利益は減少

(単位：百万円)

科目	22.3期通期 実績	23.3期通期 実績	対前年同期比 増減率	23.3期通期 予想	対予想比 増減率
売上高	30,864	31,956	3.5%	33,000	▲3.2%
営業利益	3,897	3,976	2.0%	5,000	▲20.5%
営業利益率	12.6%	12.4%	▲0.2pt	15.2%	▲2.8pt
経常利益	4,124	3,981	▲3.5%	5,000	▲20.4%
親会社株主に帰属する 当期純利益	3,157	2,179	▲31.0%	3,500	▲37.7%
EPS（円）	288.60	198.69	▲31.2%	318.23	-
海外売上高比率（*1）	67.6%	70.0%	2.4pt	-	-
平均為替レート（1\$=）	¥112.9	¥134.9	-	¥135.0	-
減価償却費	1,311	1,645	25.5%	1,904	▲13.6%
設備投資	1,916	4,850	153.1%	5,334	▲9.1%

(*1)海外売上高比率：外貨建て売上比率

(単位：百万円)



トレックス

- 通期では半導体の需要増加の影響により増収、上場来最高
- 3Q以降は在庫調整の影響を受けて減速

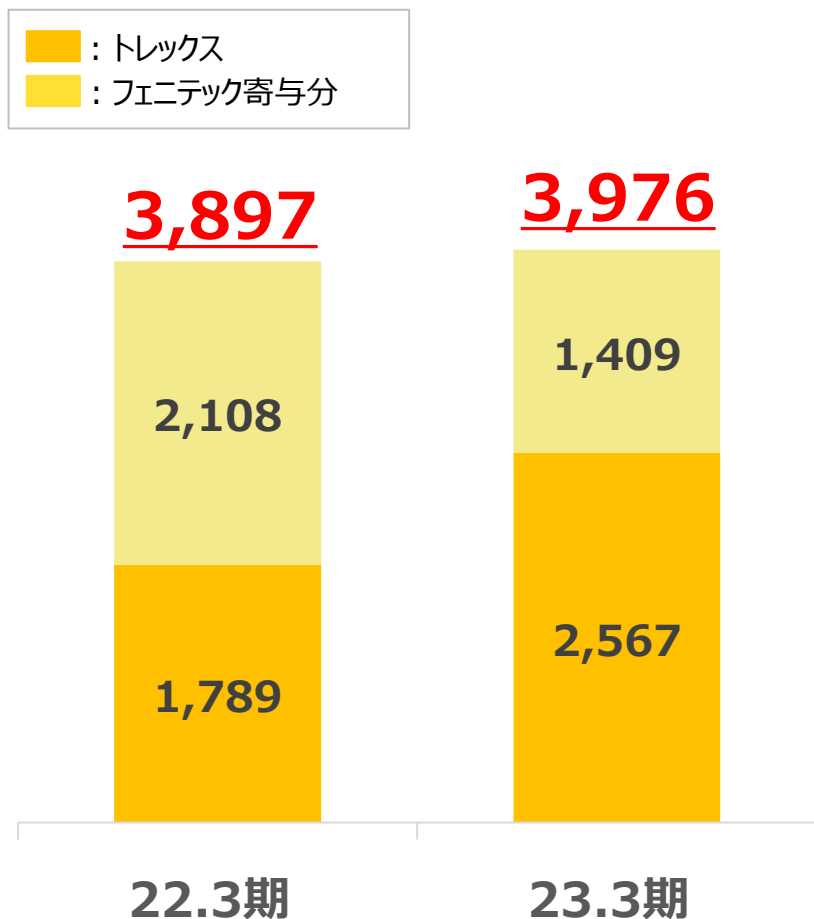
フェニテック

- 好調な市場環境により増収、連結子会社化以後最高
- 3Q以降は、小電力ディスクリートは調整局面、パワー半導体は好調維持

(単位：百万円)

	22.3期 実績	23.3期 実績	対前年同期比増減率
売上高	30,864	31,956	3.5%

(単位：百万円)



➤ トレックス

- 前半の売上高の急増により増益。
上場来最高を更新

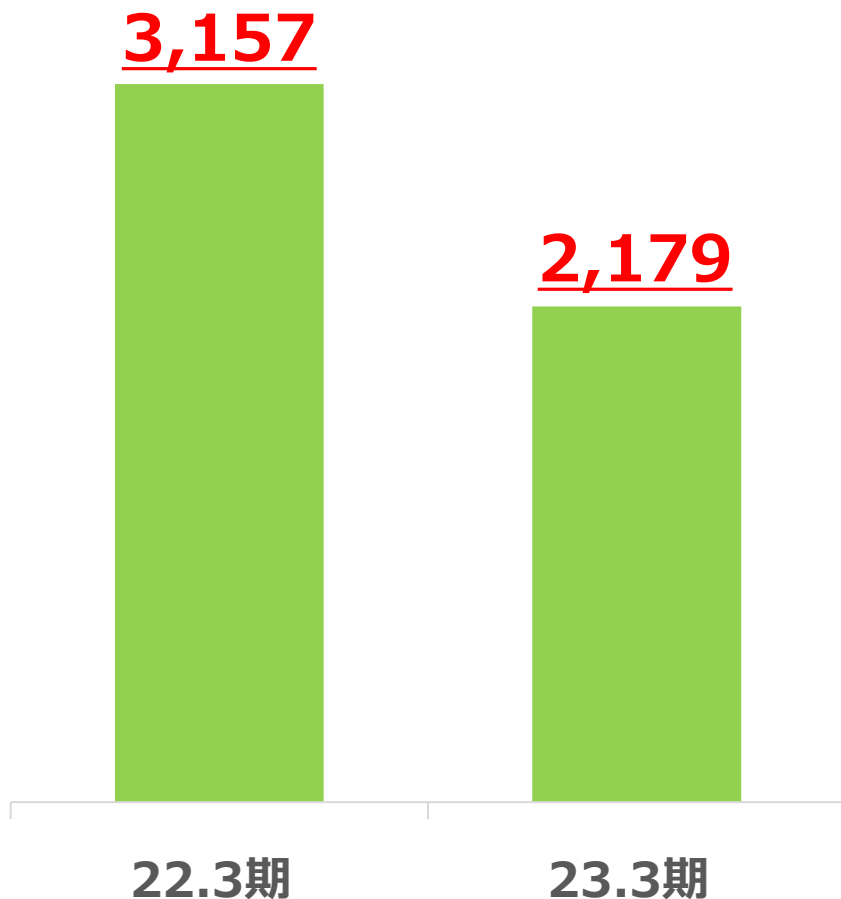
➤ フェニテック

- 下期の受注減により工場稼働率が低下
- 電力料等の原価の増加も影響し、減益

(単位：百万円)

	22.3期 実績	23.3期 実績	対前年同期比増減率
営業利益	3,897	3,976	2.0%

(単位：百万円)

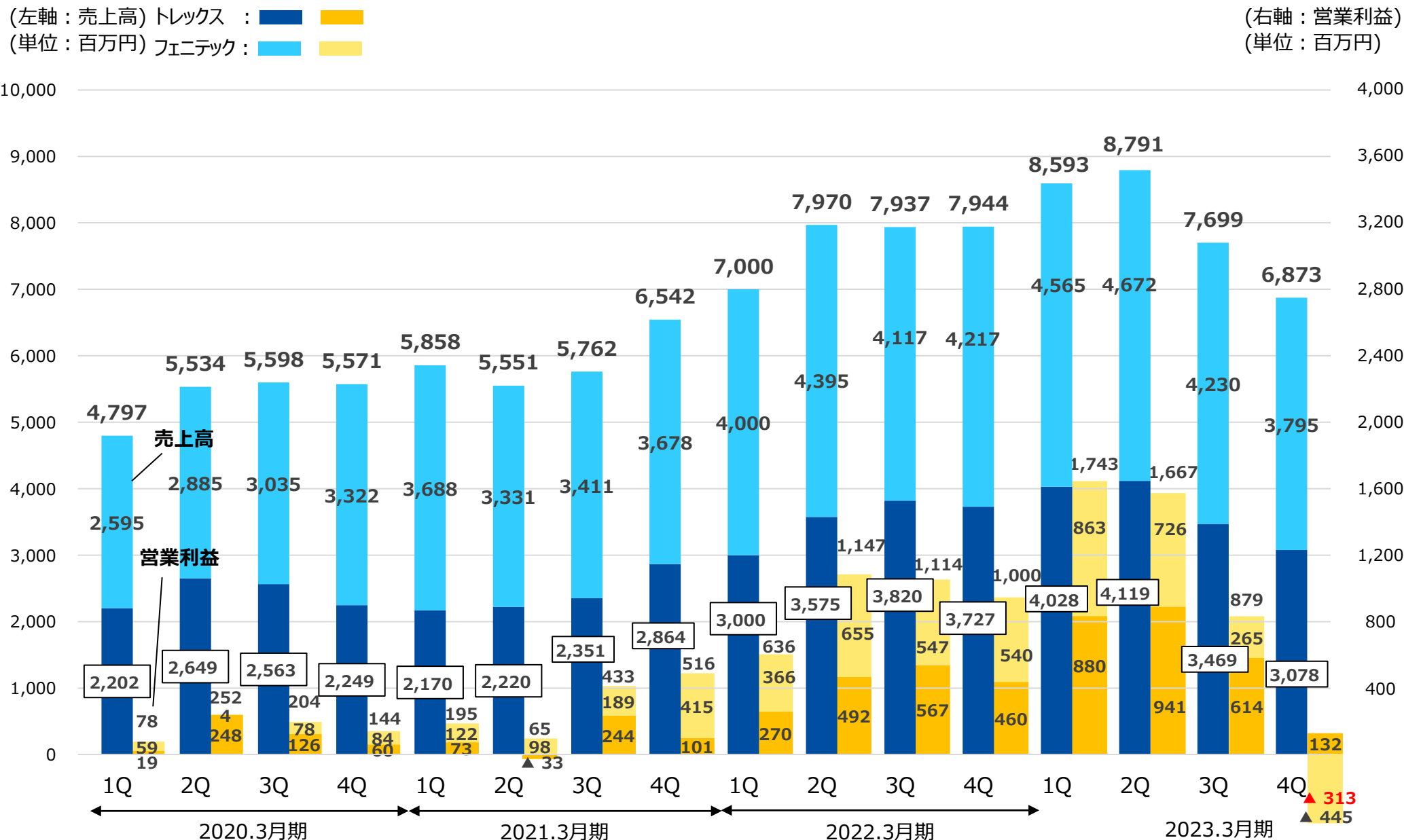


- フェニテック鹿児島工場において、プロダクトミックスの変化により減損を実施
- トレックスのメインFabとして、新たに効率化した設備を投入し、収益性の改善を計画
(2028年度に向けた資産の適正化)

(単位：百万円)

	22.3期 実績	23.3期 実績	対前年同期比増減率
当期純利益	3,157	2,179	▲31.0%

売上高・営業利益の四半期推移



(単位：百万円)

科目	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
業績予想	33,000	5,000	5,000	3,500
実績	31,956	3,976	3,981	2,179
差額	▲1,043	▲1,023	▲1,018	▲1,320

➤ 売上高の減少理由

- TRX：市況の変化に伴う急激な顧客の納期調整
- PTS：一部顧客の納期調整に伴う生産の平準化

➤ 営業利益の減少理由

- TRX：売上の減少に伴う利益減
- PTS：売上の減少に伴う利益減及び先送りにしていたオーバーホールの一括実施

➤ 当期純利益の減少理由

- 上記のほか、PTS鹿児島工場の減損

(単位：百万円)

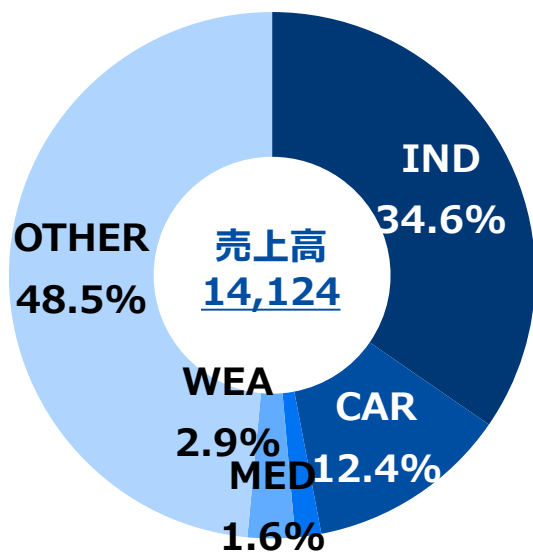
科目	22年3月期末	23年3月期末	対前期末増減
資産	34,770	37,048	2,278
負債	12,041	12,454	413
純資産	22,729	24,593	1,864

<参考> キャッシュ・フロー関連指標の推移

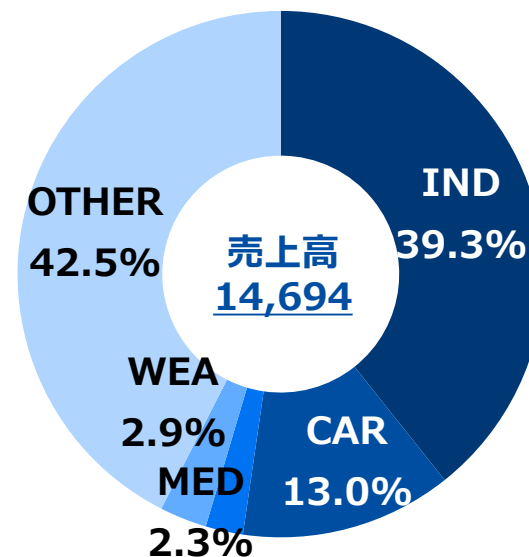
科目	22年3月期末	23年3月期末	対前期末増減
有利子負債	5,762	7,734	1,972
自己資本比率	65.4%	66.4%	1.0pt
D/Eレシオ	0.25	0.31	0.06

トレックス／フェニテック 各単体

TOIREX



22.3期実績



23.3期実績

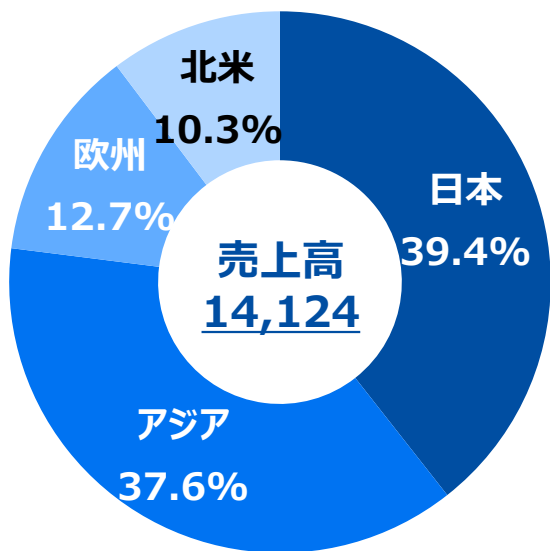
(単位：百万円)

アプリケーション	22.3期		23.3期		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
IND 産業機器	4,885	34.6%	5,770	39.3%	18.1%
CAR 車載機器	1,753	12.4%	1,908	13.0%	8.9%
MED 医療機器	222	1.6%	336	2.3%	51.35%
WEA ウェアラブル機器	411	2.9%	431	2.9%	4.9%
OTHER その他機器	6,853	48.5%	6,245	42.5%	▲8.9%

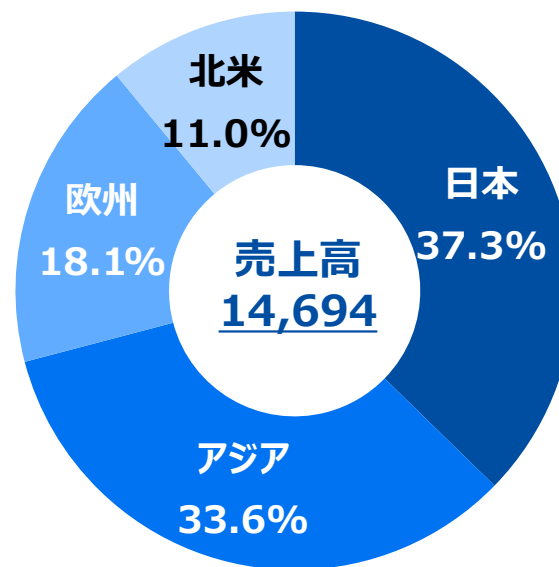
※注：アプリケーションの分類は変更することがあります。その他機器とは、家電等の民生機器です。

2023年3月期 ～地域別売上高（トレックス）

TOIREX



22.3期実績

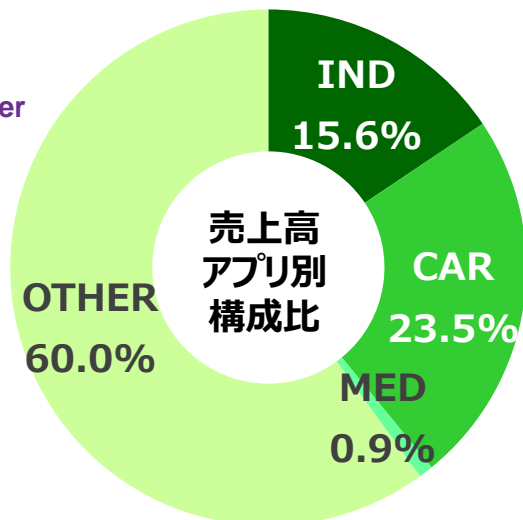


23.3期実績

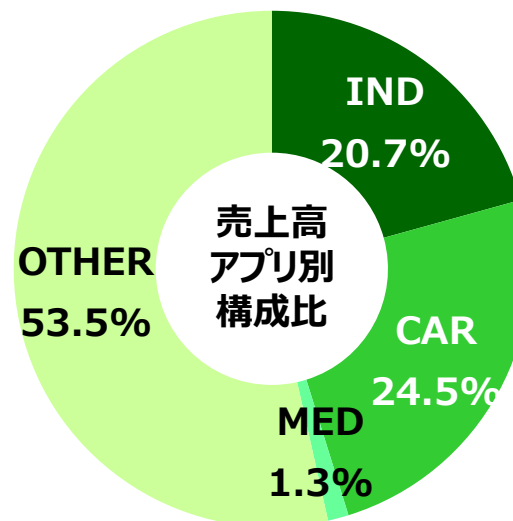
(単位：百万円)

地域 (D-in)	22.3期		23.3期		対前年同期比 増減率
	D-in 売上高	構成比	D-in 売上高	構成比	
日本	5,566	39.4%	5,474	37.3%	▲1.7%
アジア	5,307	37.6%	4,944	33.6%	▲6.8%
欧州	1,798	12.7%	2,657	18.1%	47.8%
北米	1,453	10.3%	1,617	11.0%	11.3%
平均為替レート (1\$=)	112.9円		134.9円		-

D-in 売上高：デザイン・イン・ベース売上高。当社の製品を搭載した製品が企画・設計され、実質的に受注を獲得した地域をベースとした売上高



22.3期実績



23.3期実績

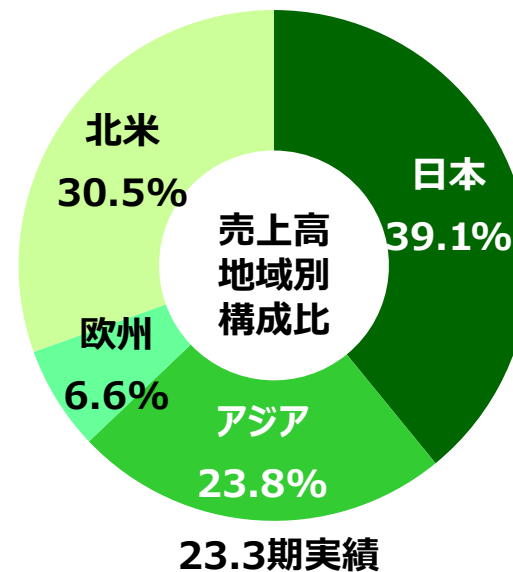
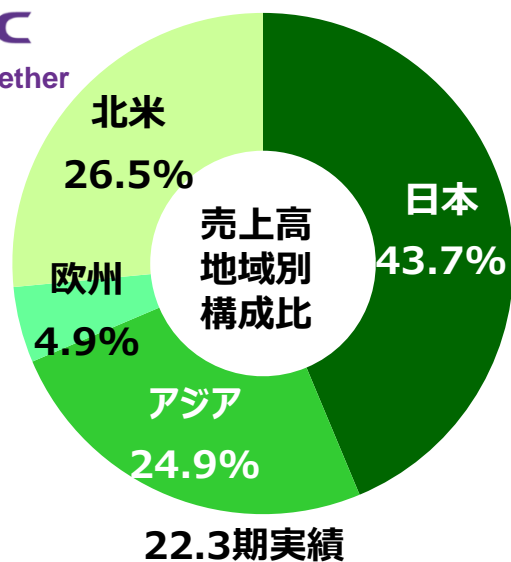
(単位：百万円)

アプリケーション	22.3期		23.3期		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
IND 産業機器	2,982	15.6%	4,026	20.7%	35.0%
CAR 車載機器	4,488	23.5%	4,757	24.5%	6.0%
MED 医療機器	170	0.9%	252	1.3%	47.6%
OTHER その他機器	11,442	60.0%	10,413	53.5%	▲9.0%

※注：アプリケーションの分類は変更することがあります。
トレックス・セミコンダクター向けの内部取引分を含む

2023年3月期 ～地域別売上高（フェニテック）

Phenitec
For Further Growth Together



※ 顧客の所在地別に区分しています。

(単位：百万円)

地域（顧客）	22.3期		23.3期		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
日本	8,348	43.7%	7,609	39.1%	▲8.9%
アジア	4,746	24.9%	4,620	23.8%	▲2.7%
欧州	940	4.9%	1,295	6.6%	37.7%
北米	5,048	26.5%	5,924	30.5%	17.3%
平均為替レート（1\$=）	112.9円		134.9円		—

※注：日本には、トックス・セミコンダクター向けの内部取引分を含む

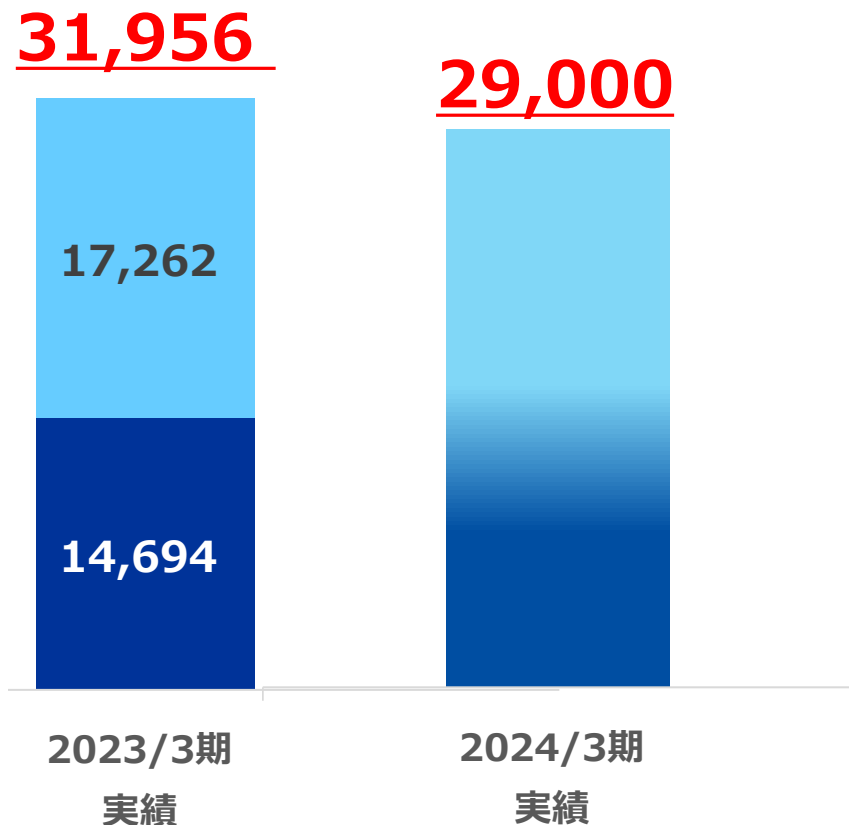
2024年3月期 業績予想

(単位：百万円)

	23.3期 通期実績	24.3期 業績予想	対前年 同期比 増減率
売上高	31,956	29,000	▲9.3%
営業利益	3,976	1,500	▲62.3%
営業利益率	12.4%	5.2%	▲7.2pt
経常利益	3,981	1,500	▲62.3%
親会社株主に 帰属する当期純利益	2,179	1,050	▲51.8%
EPS (円)	198.69	95.47	-
平均為替レート (1\$=)	¥134.9	¥130.0	-
減価償却費	1,645	2,487	51.1%
設備投資	4,850	5,917	22.0%

(単位：百万円)

■ : トレックス
■ : フェニテック寄与分



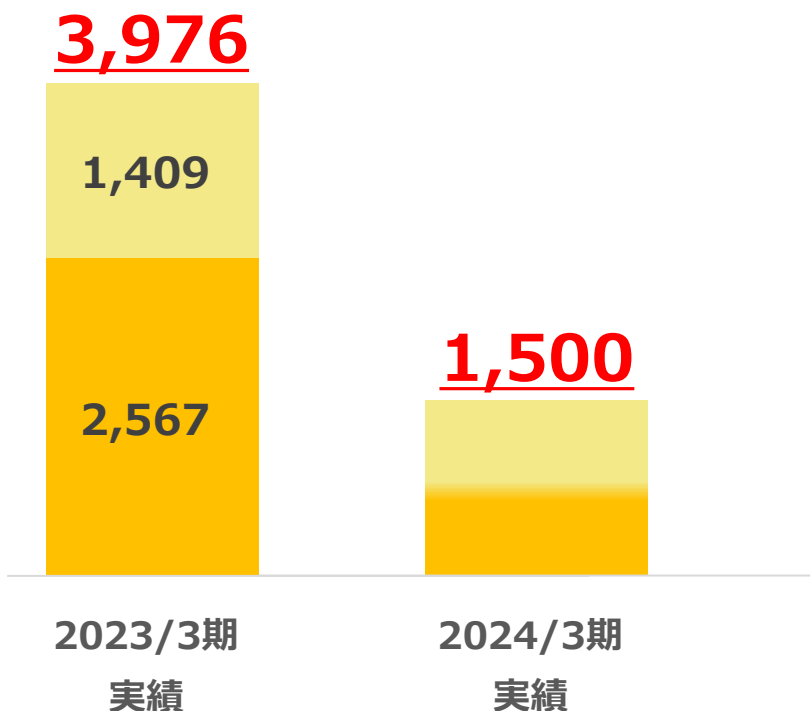
- 顧客の在庫調整の長期化を見込み、トレックス、フェニテックともに減収と予測
- 特に上期は厳しい市況を想定

(単位：百万円)

	2023年3月期 実績	2024年3月期 業績予想	対前年増減率
売上高	31,956	29,000	▲9.3%

(単位：百万円)

■ : トレックス
 ■ : フェニテック寄与分



新規設備の稼働に伴う減価償却費の発生と電力料等の原価高騰継続を見込み、減益と予測

	2023年3月期 実績	2024年3月期 業績予想	対前年増減率
営業利益	3,976	1,500	▲62.3%

トピックス

中期経営計画

2023年度

連結売上高：300億円

営業利益：30億円

2025年度

連結売上高：350億円

営業利益：40億円

DOE：3.0%

実績

2021年度

連結売上高：308億円

営業利益：38.9億円

2022年度

連結売上高：319億円

営業利益：39.7億円

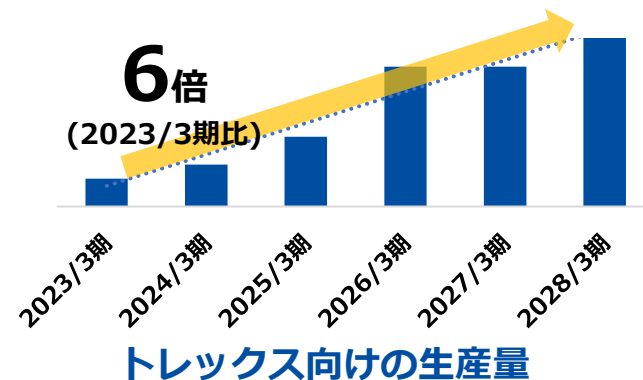
営業利益において、2025年度計画に近似。
また、グループとして中計期間で126億の設備投資を実施し、
売上 1.5 倍以上の生産キャパを確保

→ 環境変化に伴い、**新たに中期の業績目標※を設定。**

※以下、「拡大中期業績目標」と呼称

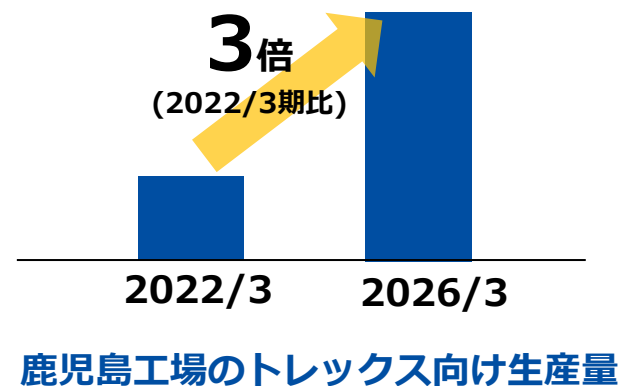
●海外ファウンドリ1社と長期生産委託契約を締結

- ・委託先の工場増設に当社資金を一部充当し、中高耐圧を含む、高機能/高性能な新製品の展開に必要な8インチ生産枠を確保
- ・25/3期生産ラインが量産稼働予定
- ・投資額：18億円



●フェニテック鹿児島工場にトレックス向け生産ライン増設

- ・既存ラインへ設備投資を行い、トレックス向け生産ラインを拡大
- ・更にクリーンルーム増床と設備投資を行い、トレックス向けを含む生産ラインを拡大
- ・投資額：44億円



●フェニテック岡山・鹿児島工場における他の増産設備投資

- ・半導体市況好調に対応するため、約20億円を投資

※ その他、工場維持等で44億の設備投資を実施

トレックスグループ 拡大中期業績目標

2025年度

連結売上高：370億円

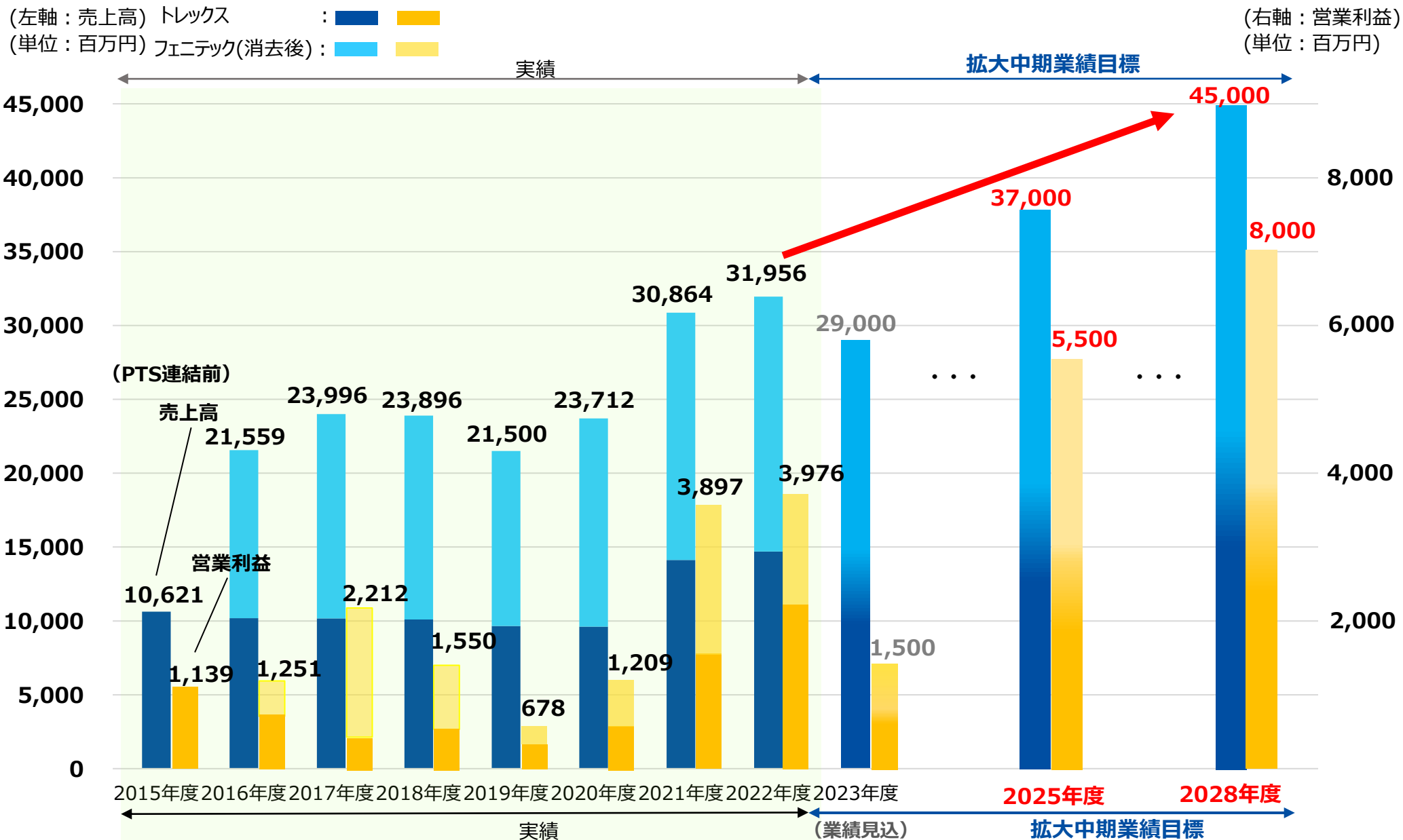
営業利益：55億円

2028年度

連結売上高：450億円

営業利益：80億円

売上高・営業利益 8カ年実績推移と拡大中期業績目標

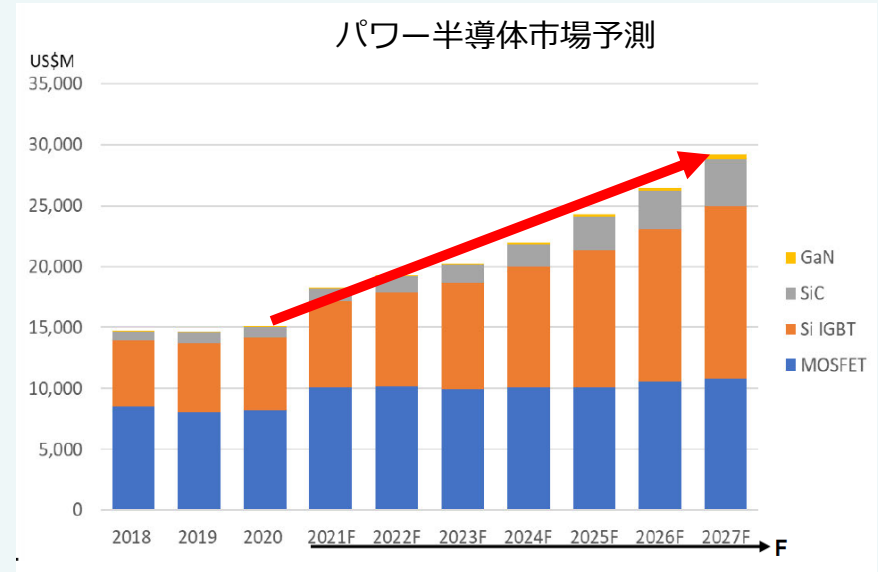
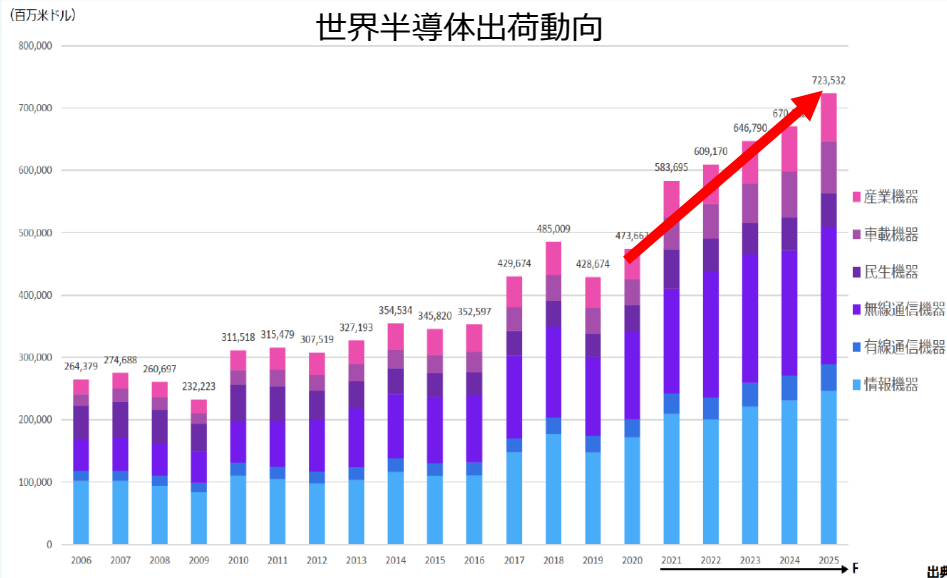


・世界半導体出荷動向（全体）

⇒ 2020年→2025年 \$473Bから **1.5倍** の \$723Bに成長と予測

・パワー半導体

⇒ 2020年→2027年 \$15Bから **2倍** の 約30Bに成長と予測



トレックス・セミコンダクター

● トレックス 電源ICに加え、パワー半導体製品も強化

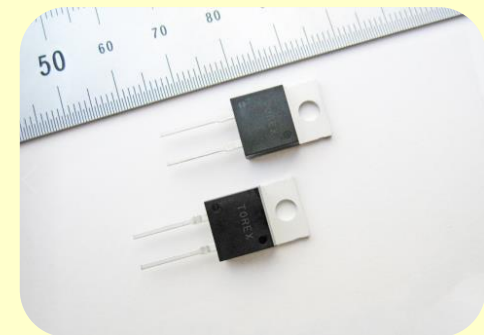
パワー半導体強化プロジェクトを始動し、強力に推進

- ・ **MOS-FET**ラインナップ拡充（低Vth製品、中耐圧大電流製品、低リーク）
- ・ **IGBT** 製品開発の検討
- ・ **SiC** 製品開発推進、製品の具体化
 - ⇒ **フェニテック製 SiC-SBD** トレックスよりPKG品サンプル提供開始
 - ⇒ 順次、製品ラインナップを拡大
- ・ **酸化ガリウム**製品開発
 - ⇒ ノベルクリスタルテクノロジー社と共同開発

2023年5月12日 プレスリリース

トレックスでは、フェニテックセミコンダクターが開発した、SiC ショットキーバリアダイオード 850V／10A品のサンプル提供を開始しました。2023年の量産化を目指します。

また、本製品を皮切りに順次 650V～1200Vの製品ラインナップ化を計画しております。



[SiC-SBD TO-220AC XBSC11A108CS](#)

ノベルクリスタルテクノロジー社との協業

次世代パワー半導体であるβ型酸化ガリウムを開発する
ノベルクリスタルテクノロジー社と資本提携（2020年6月）

超低損失・低価格な酸化ガリウムの開発で世界をリード

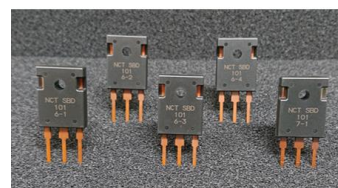


酸化ガリウムは理論的性能がシリコンより圧倒的に高く、
SiC、GaNを超え、様々な分野で期待されています。

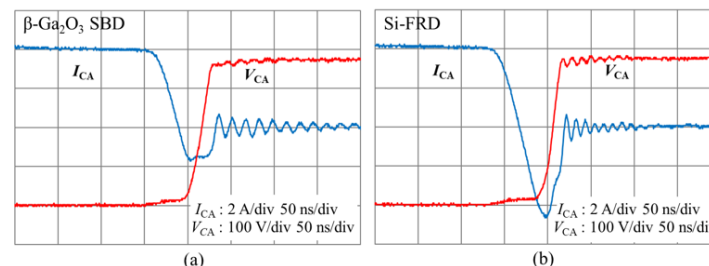
国内初、酸化ガリウムショットキーバリア ダイオード搭載の出力電力350W電流 連続型力率改善回路の実機動作確認 に成功 -高出力・高耐圧・優れた省エネ性を実証-

NEDOの「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」の一環として「β-Ga₂O₃ショットキーバリアダイオードの製品化開発」に取り組む(株)ノベルクリスタルテクノロジーは、酸化ガリウム(β-Ga₂O₃)ショットキーバリアダイオード(SBD)の実機動作確認に成功しました。開発中の耐圧1200Vのβ-Ga₂O₃SBDを電流連続型PFC(力率改善)回路に搭載し、評価を行ったところ、回路の出力電圧390V、出力電力350Wという高出力で正常に動作することを確認しました。高出力で実機動作を確認したのは国内初となります。また、本用途で広く使用されているシリコン(Si)製のファストリカバリーダイオード(SiFRD)と電力変換効率を比較したところ、1%の効率改善という結果が得られ、省エネ性にも大変優れていることが確認できました。本実機動作の確認は、中耐圧(600-1200V)のβ-Ga₂O₃SBDがパワーエレクトロニクス機器に採用されるための大きな実証事例になると考えられます。

2023年4月6日付 ノベルクリスタルテクノロジー社 プレスリリースより



開発したβ-Ga₂O₃SBDパッケージ
写真 (同プレスリリースより)



逆回復リカバリー特性 (a)β-Ga₂O₃SBD搭載 (b)SiFRD搭載

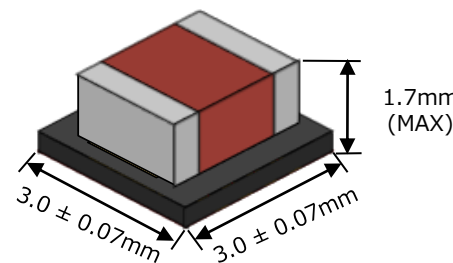
● 豊富な構造で、適材適所に対応するTRXの “ micro DC/DC ”

- ・ DC/DCコンバータとコイルを一体化することで、基板の実装面積を削減
- ・ 低ノイズ、小型、高放熱に優れ、あらゆるシーンで高効率で安定した電源回路構成が可能
- ・ 中高耐圧／大電流化に向け、更なる進化を続けています。

構造名	ポケット タイプ	スタック タイプ	マルチプル タイプ	クールポスト タイプ
構造図				
構造説明	ICをコイルで覆ってしまう方法	コイル上にICをスタックする方法	コイルとICを横に並べる方法	モールドされたICにコイルをスタックする方法
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 放射ノイズ ◎ 近傍磁界 △ コスト ◎ 実装面積 ○ 大電流 ○ 放熱 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 放射ノイズ △ 近傍磁界 ◎ コスト ○ 実装面積 △ 大電流 △ 放熱 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 放射ノイズ ○ 近傍磁界 ○ コスト △ 実装面積 ◎ 大電流 ◎ 放熱 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 放射ノイズ ○ 近傍磁界 △ コスト ○ 実装面積 ○ 大電流 ◎ 放熱
製品	XCL100/XCL101 (昇圧) XCL102/XCL103 (昇圧) XCL201/XCL202 (降圧) XCL205/XCL206 (降圧) XCL210 (降圧) XCL232 (降圧)	XCL208/XCL209 (降圧)	XCL211/XC212 (降圧)	XCL104/105 (昇圧)

多機能DC/DCコンバータ コイル一体型昇圧 “micro DC/DC” XCL104/XCL105 シリーズ

- ・ 同期整流ドライバ/スイッチ FET内蔵
- ・ 負荷切断 / 出力OR / OFF時バイパスの選択可能
- ・ 高放熱・小型パッケージ (クールポストタイプ)



DFN-3030-10B (クールポストタイプ)

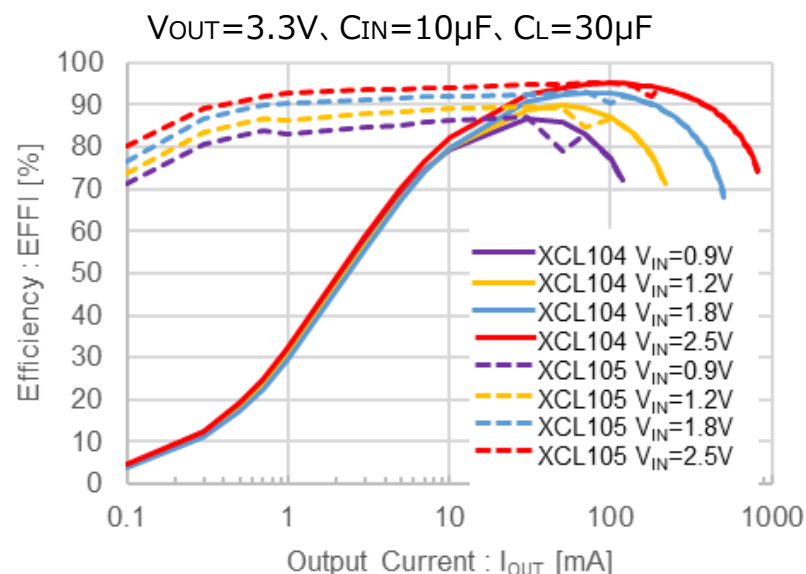
製品の特長

- ・ 乾電池1本からの昇圧に使用可能 (0.9V起動)
- ・ 入力電流 : 1400mA
- ・ PWM/PFM 自動切替制御 (XCL105)

ターゲットアプリケーション

ポータブル機器、電子辞書、ペンライト、玩具、
マウス、ICレコーダ、リモコン、IoT器機
会議用システム・マイク、
スマートメータ用バックアップ電源

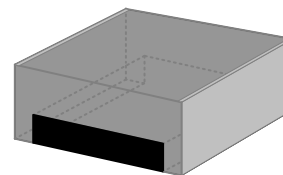
電力変換効率特性例



小型、超低消費、コイル一体型降圧 “micro DC/DC” XCL233 シリーズ

まもなく
量産

- 超低消費 : **200nA**
- 出力電流10 μ Aでも効率80%以上を実現
- **VSET機能**で待機時の出力電流を下げ、更に低消費電力



CL-2025-03 (ポケットタイプ)



製品の特長

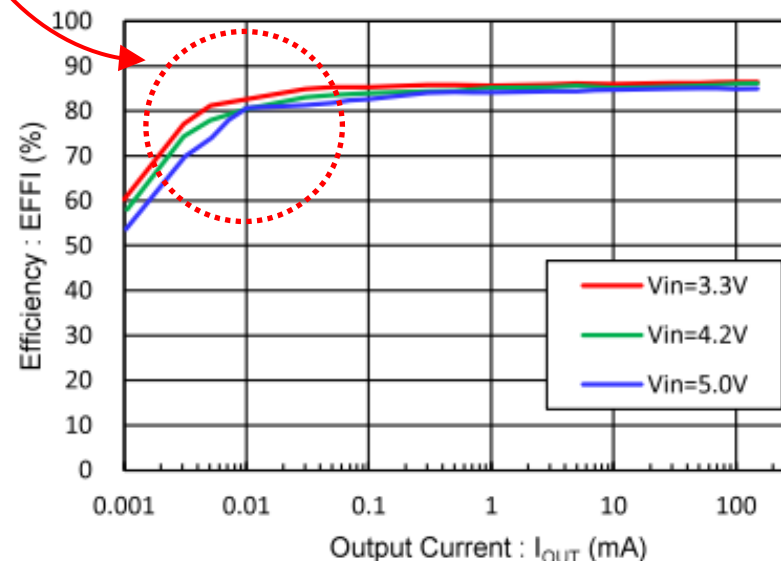
- 待機時電流から高い電力変換効率
- 出力電流 : 150mA
- VSET機能で出力電圧を2値切替
- 超小型、低EMIパッケージ (ポケットタイプ)

ターゲットアプリケーション

スマートウォッチ、スマートメータ、ウェアラブル
各種センサーモジュール、IoT器機
エネルギーハーベスト

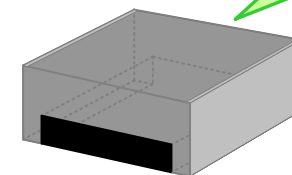
電力変更効率特性例

$V_{OUT} = 1.8V$, $C_{IN} = 10\mu F$, $C_L = 20\mu F$, $T_a = 25^\circ C$



小型、超低消費、コイル一体型昇圧 “micro DC/DC” XCL108 シリーズ

- 超低消費：400nA
- 出力電流10 μ Aでも効率70%以上を実現
- IoT/ウェアラブル用途の電池駆動長時間化に最適



開発中

CL-2025-02 (ポケットタイプ)

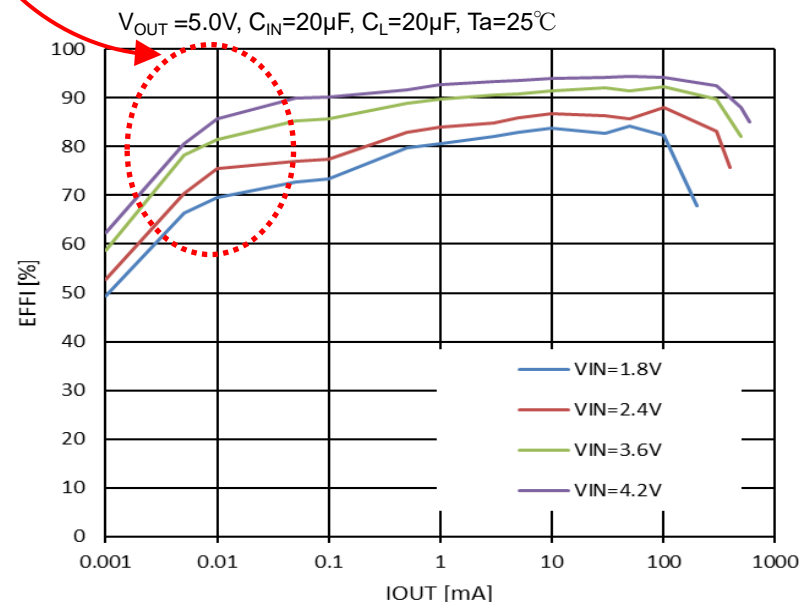
製品の特長

- 待機時電流から高い電力変換効率
- ドライバ内蔵同期整流
- 入力電流：800mA
- 超小型、低EMIパッケージ（ポケットタイプ）

ターゲットアプリケーション

ポータブル機器、ウェアラブル機器、
LPWAN (LoRa, Sigfox, NB-IoT)
スマートメータ用バックアップ電源、IoT器機
美容/医療機器、エナジーハーベスト

電力変換効率特性例



20V入力 200mA 低消費1.2 μ A 高速レギュレータ

XC6705/06 シリーズ

- ・高精度、高リップル除去、CMOS高速低消費 LDO
- ・シームレス GO機能※で低消費と高速応答を両立
- ・リチウムイオン 2セルや12Vラインに最適

※低消費電流と高速応答を両立

製品の特長

- ・低消費電流：1.2 μ A
- ・シームレスGO機能
- ・超小型から高放熱パッケージを選択可能

ターゲットアプリケーション

白物家電（エアコン、LED証明、洗濯機）
DSC一眼レフ、カムコーダ、通信モジュール、
スマートメータ、センサー

検出 センス端子分離 遅延付き 電圧検出器

XC6138 シリーズ

- ・幅広い検出／解除ヒステリシス幅の設定が可能
- ・解除／検出遅延時間の外部調整が可能
- ・VSEN：76Vmax 動作

製品の特長

- ・V_{DF}：2.3V~20V、V_{DR}：2.5V~24V
- ・Ta = -40°C~125°C
- ・幅広いヒステリシス幅が選択可能：5%~25%

ターゲットアプリケーション

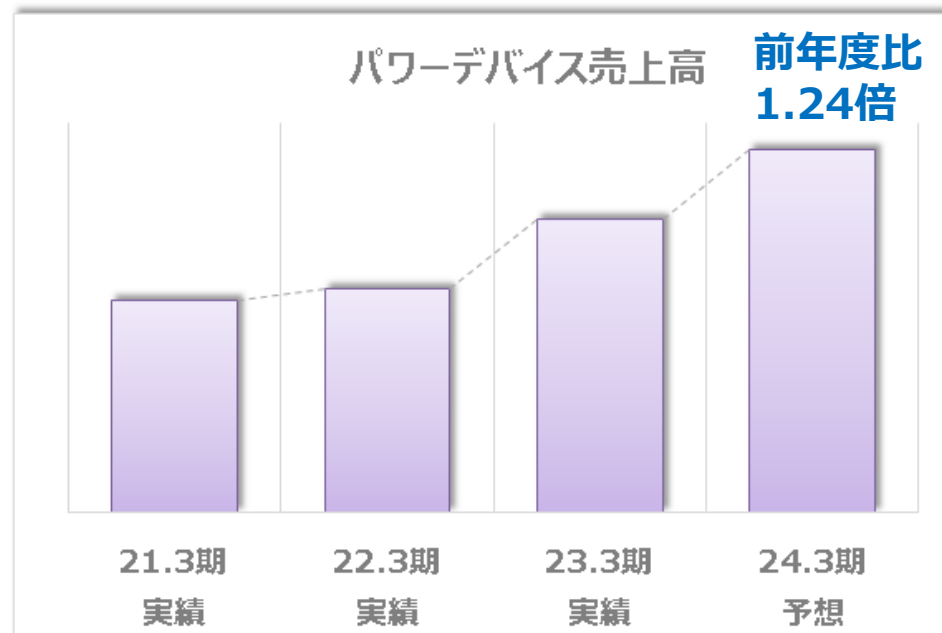
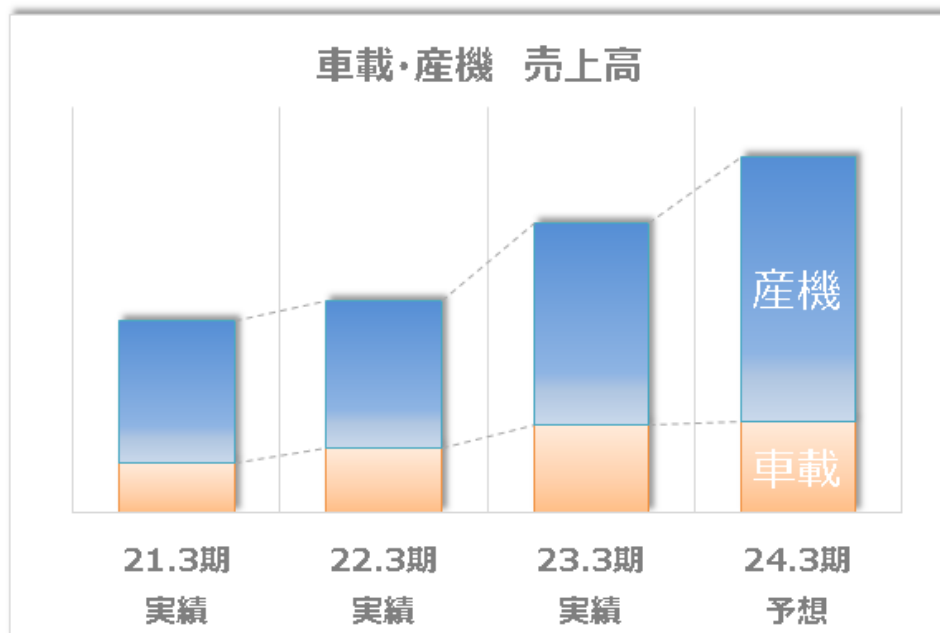
車載用バッテリーの電圧監視
リチウムイオン電池2セルの電圧監視
USB Type-C（パワーデリバリ）の電圧監視

フェニテック セミコンダクター

Siパワーデバイスの受注は引き続き高水準を維持

要因：自動車の電動化、産業機器、5G、新エネルギーなどの需要好調

デバイス：IGBT、MOSFET、SBD



化合物半導体材料に対応したプロセス技術開発 パワー半導体供給ニーズに応える

取扱い：炭化ケイ素 (SiC)、酸化ガリウム (Ga₂O₃)、窒化ガリウム (GaN)

✓市場要求に応えるパワー半導体の開発により更なる売上アップを目指す

Siパワーデバイス開発計画

2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
<p>新たなパワーデバイス開発により更なる売上アップを目指す</p>			
<p>★ Low Vth MOSFET</p> <ul style="list-style-type: none"> 医療系、産業系など高密度実装機器をターゲットに低電圧駆動（1.5V以下）製品を開発 		<p>・顧客評価中, 2023年6月量産予定</p>	
<p>★ スプリットゲート型MOSFET</p> <ul style="list-style-type: none"> 非常に低オン抵抗を実現し、より小さなパッケージで高い電流密度を実現(電池の長寿命化等貢献) 		<p>・試作評価中</p>	
<p>★ フィールドストップ型IGBT</p> <ul style="list-style-type: none"> 高入カインピーダンス、高いスイッチング速度、高耐圧且つ低オン抵抗素子フィールドストップIGBTの先端性能を目指した開発 		<p>・24.3期Q2サンプル出荷予定</p>	
<p>★ ハイパフォーマンス ショットキーバリアダイオード</p> <ul style="list-style-type: none"> デバイス構造の変更により、VF/IRのトレードオフを大幅に改善 リーク電流を抑えることで、ジャンクション温度150℃保証が可能に 		<p>・サンプル出荷済, 24.3期Q3量産予定</p>	

売上UP

SBD サンプル提供中/MOS FET サンプル作成開始

SBD 650V/10A , 850V/10A

- ・Gen1 (第1世代) 24.3期量産予定
- ・Gen2,3(第2,3世代) 開発完了
- ・Gen3(第3世代) 高いIFSMを達成
- ・サンプル提供中/顧客評価中

SBD 1200V/10A

- ・Gen2,3(第2,3世代) 開発完了
- ・サンプル提供中/顧客評価中

MOS FET 1200V

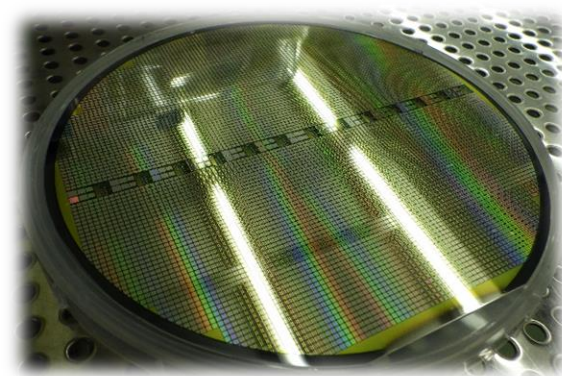
- ・プレーナー型 設計完了/サンプル作成開始
- ・トレンチ型 開発中



サイコックス社製
貼り合わせSiC基板
SiCkrest[®] (サイクレスト[®])

- ✓ 基板コスト低減
- ✓ 工程の簡略化
- ✓ チップサイズシュリンク

- ✓ 低価格
- ✓ 高品質



23.3期 24.3期 25.3期 26.3期 27.3期 28.3期 29.3期 30.3期 31.3期 32.3期

売上予想

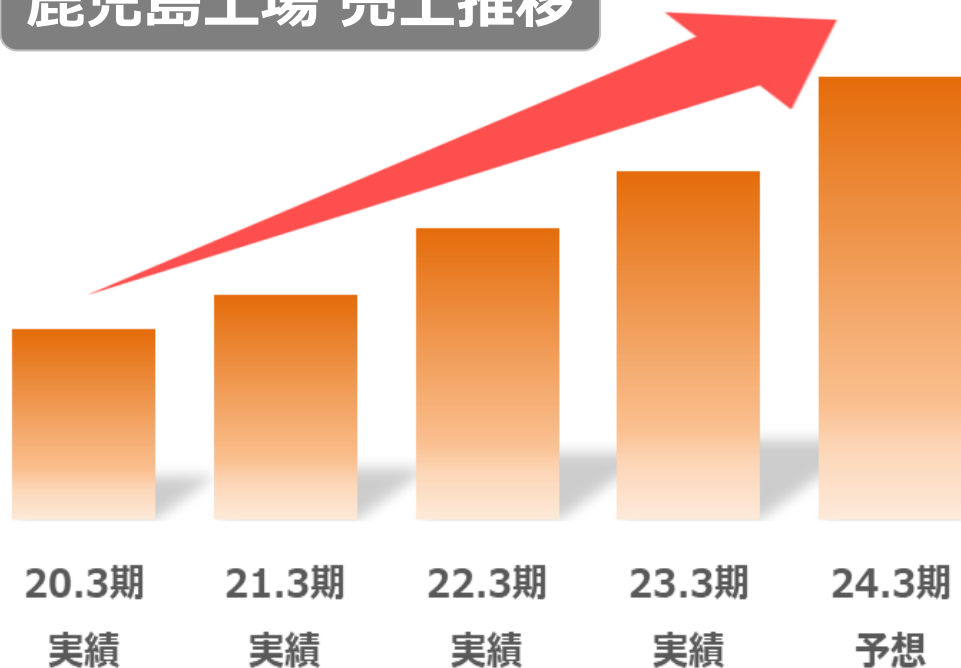
✓ 更なるデバイス開発へ向けて、産総研発起「つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション(TPEC)」に参画、MOSFETの研究開発中

鹿児島工場の取組み

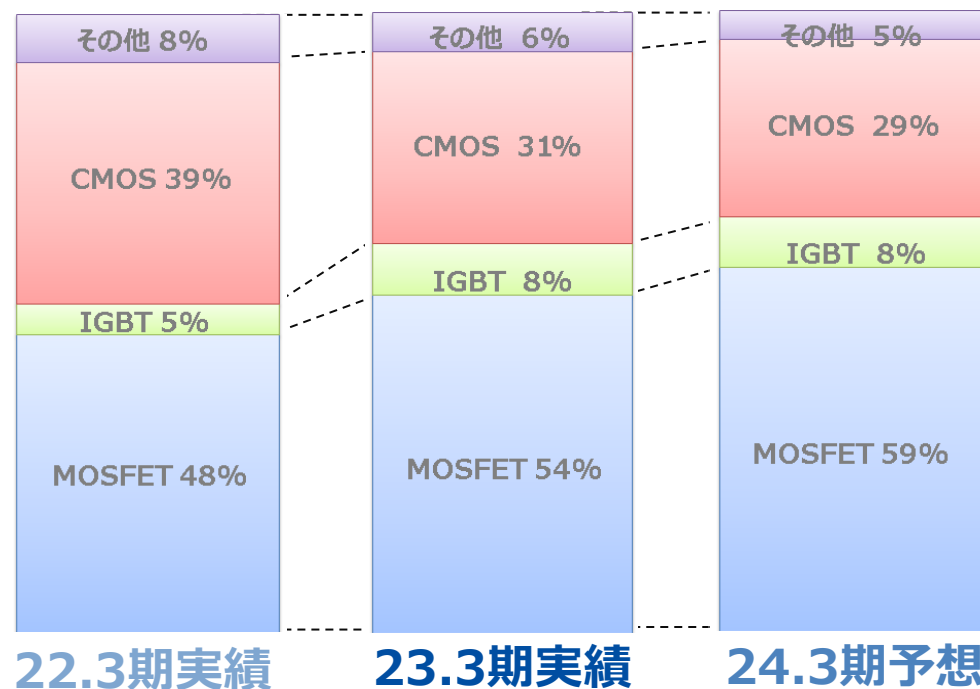
- ✓ 事業計画達成に向けた生産能力増強
- ✓ 製造固定費削減による安定した収益の確保
- ✓ トレックス アナログ電源IC増産に向けて生産能力を拡充

24.3期 20,000枚/月 安定した生産体制へ

鹿児島工場 売上推移



主な量産製品と構成比



トックス メインFABの一つとして鹿児島工場生産能力増強

- ・ アナログ電源IC 生産能力増強
- ・ 生産能力増強に関わる設備投資 総額44億円
(内 24.3期設備投資 30億円を計画)
- ・ 装置増設 23.3期Q4より導入開始
- ・ クリーンルーム増床 2023年6月 着工予定
2024年1月 完成予定
2024年1月～ 順次装置搬入

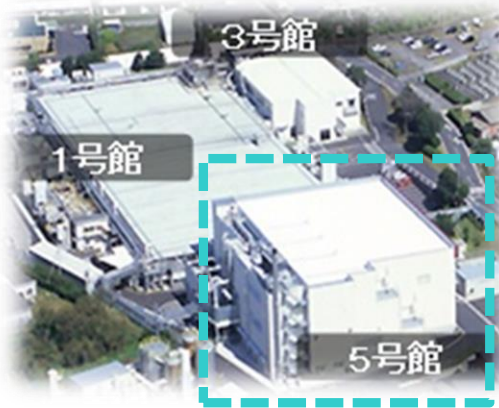
トックス製品
生産枚数推移



2023年4月6日 安全祈願祭



鹿児島工場5号館3階をクリーンルーム化



トックス製品の長期安定供給を実現

岡山工場 統合

✓ 第2工場の生産品を第1工場に集約

23.3期Q3状況

岡山工場統合計画を再開



24.3期

岡山工場統合 完了予定

岡山工場 売上推移



✓ 統合によりBCP・高い収益性・効率性の実現

生産集約

23.3期
下期から市況の
在庫調整により
受注減少

24.3期
下期より受注
回復見込



2023年4月 せとうち半導体共創コンソーシアム事業に参画

目的

広島大学ナノデバイス研究所を中心に、半導体関連の地場企業、マイクロンメモリジャパン、京セラ、日立ハイテク、中国経済産業局や広島県、東広島市など21社・団体が連携して先端エレクトロニクスの研究開発を推進するとともに、半導体産業の中核を担う人材を育成し、我が国における半導体産業の振興と地域の活性化に貢献することを目的とする。

広島大学ナノデバイス研究所 Jイノベ HUB棟建設

上記目的に賛同し、企業版ふるさと納税を利用し支援を行いました。

2023年4月25日 拠点竣工式

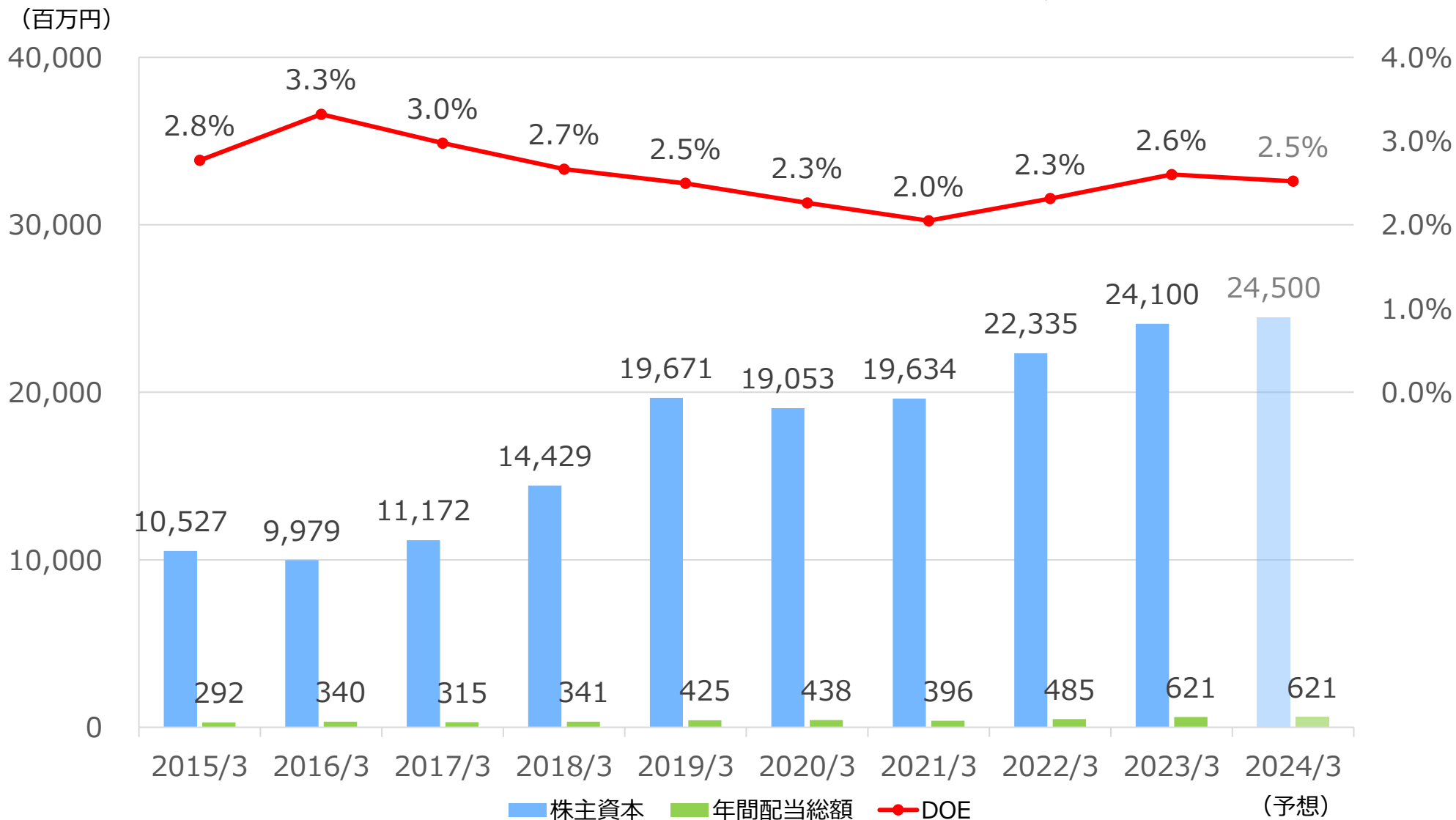


✓ 広島大学との連携強化を図り、新技術開発基盤の構築・人材採用支援に有効活用

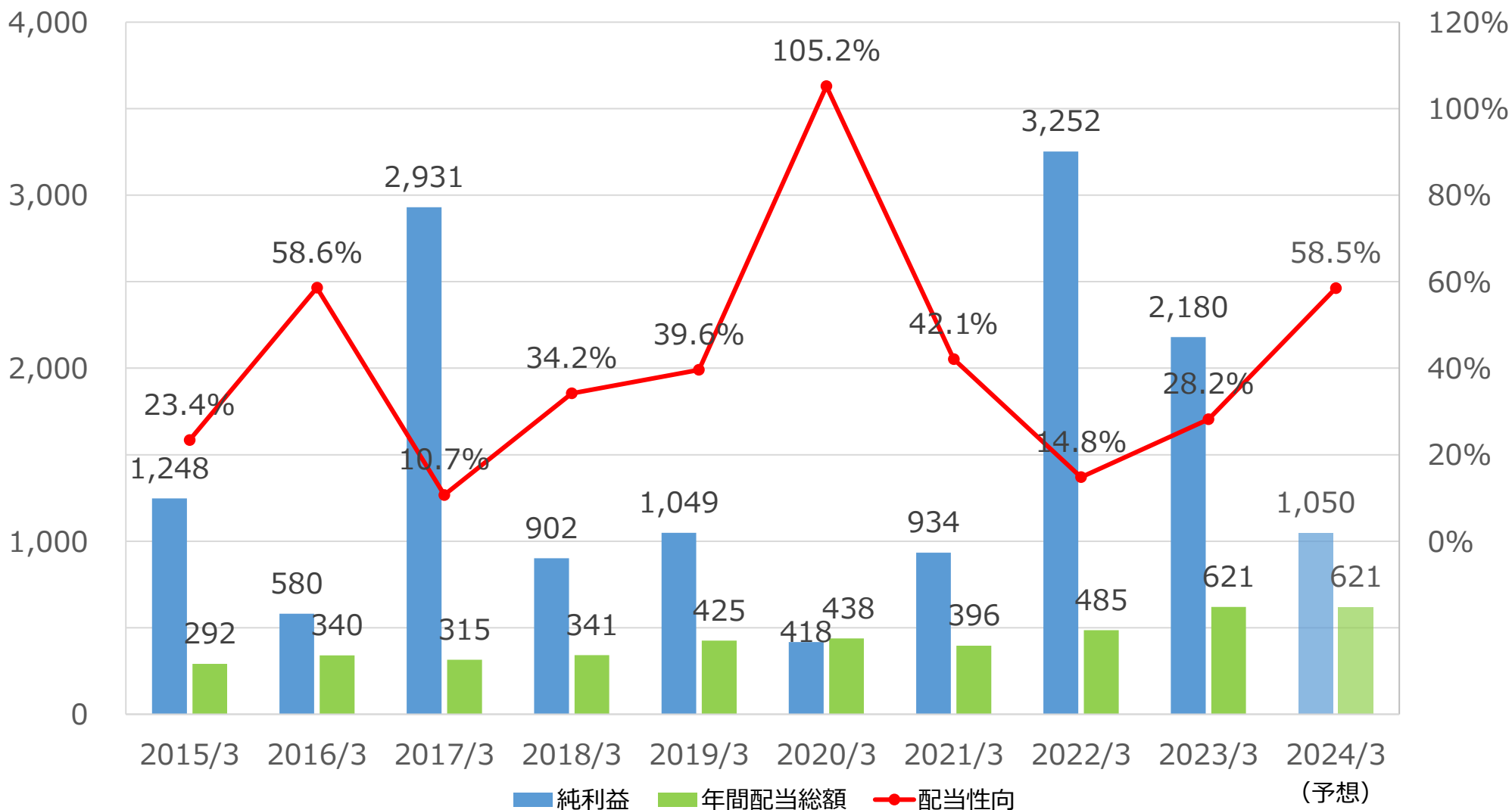
株主還元

配当につきましては、業績水準を反映した利益配分として
連結配当性向20%以上、安定的かつ継続的な株主還元
の拡充として**株主資本配当率（D O E）3%程度**を当面
の目標として実施しております。

DOEは3%程度を目標として還元



連結配当性向は 20%以上を目標として還元



本資料に記載された内容は、2023年5月18日現在において一般的に入手可能な情報と、合理的と判断する一定の前提に基づき、当社が作成したものです。

本資料に記載されている当社の中期計画、見通し等に関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。

実際の業績は、これらの要素により本資料の記載内容と大きく異なる可能性があります。

投資に関するご決定をされる際、本資料のみに全面的に依拠することはお控えいただき、みなさまご自身のご判断でなされるようお願い致します。

Appendix 会社紹介

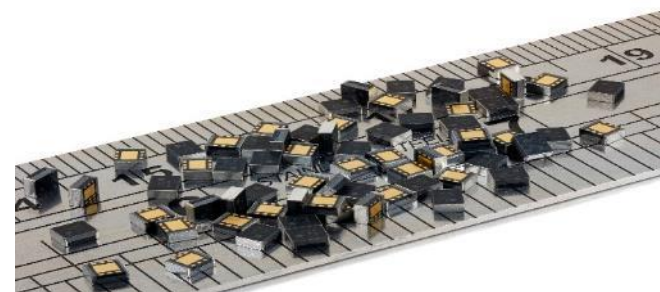
1995年に設立。2014年にJASDAQスタンダード市場に上場、東証二部、一部を経て2022年4月に東証プライム市場に上場した半導体メーカーです。

アナログのチカラ

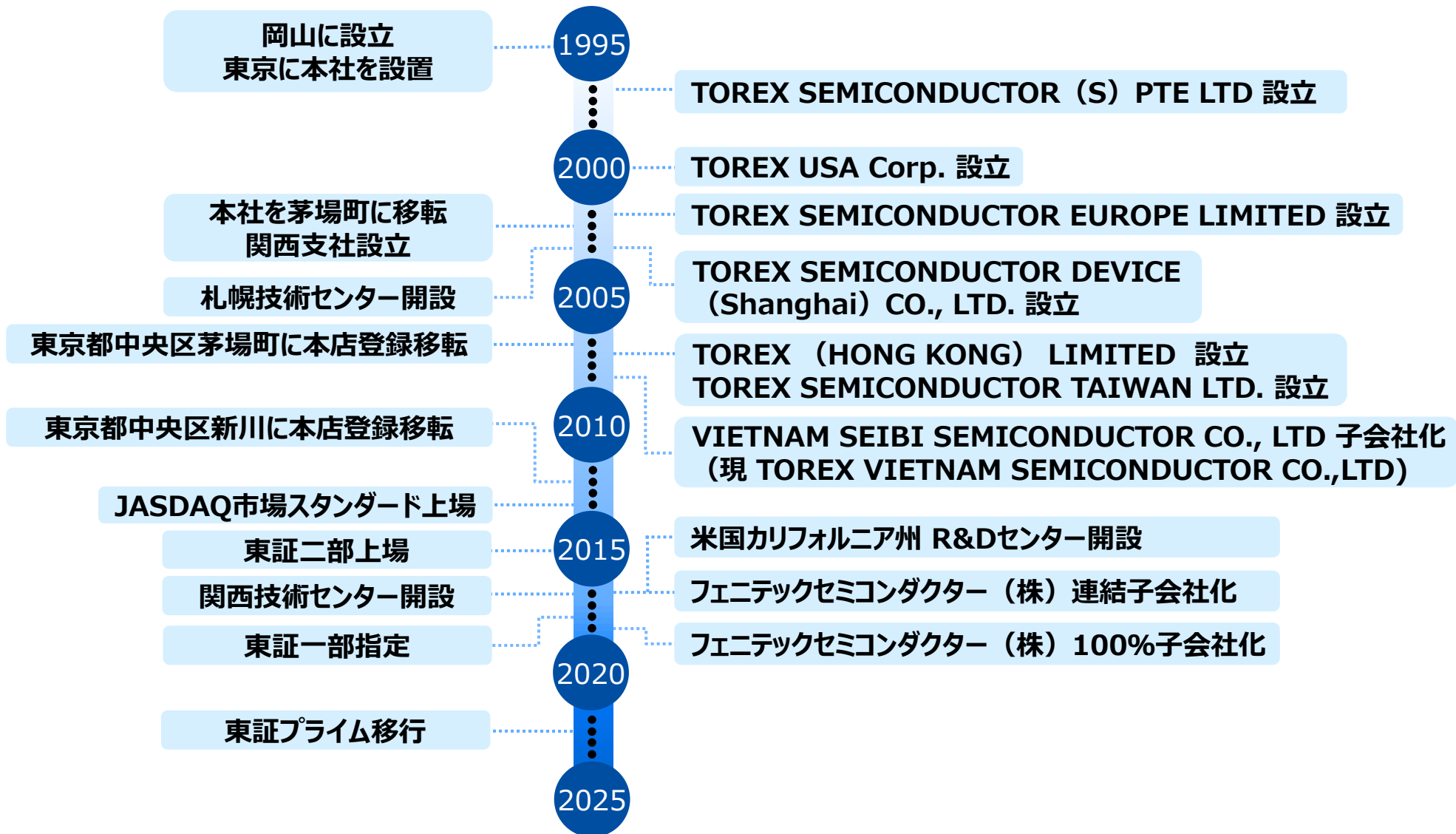
ABOUT TOREX

所在地	東京都中央区新川1-24-1 DAIHO ANNEX 3F
代表者	代表取締役社長 芝宮 孝司
資本金	29億6793万円（2023年3月31日現在）
事業内容	1.半導体デバイスの開発、設計製造 2.半導体デバイスの販売
従業員数	当社：182名 / グループ：1,063名
上場証券取引所	東京証券取引所 プライム市場
単元株式数	100株
決算期	3月末日
証券コード	6616
URL	https://www.torex.co.jp/

常に豊かな知性と感性を磨き、市場に適応した価値ある製品を創出し、豊かな社会の実現と地球環境の保全に貢献するとともに、私たちの事業に携わるすべての人々が共に繁栄することを企業の理念とする。



電源IC一筋、**省電力・小型化**の技術でエレクトロニクス産業の発展に貢献してきました。



TOIREX



トレックス・ セミコンダクター

**ファブレスメーカー
アナログ電源IC専業**

※製造委託先に占めるフェニテックのシェアは
6~7割程度

強み

- ・省電力／小型化の技術
- ・蓄積されたアナログ回路ノウハウ
- ・マーケティングと製品企画力
- ・フレキシブルな生産工場
- ・高品質をキープするQC
- ・ワールドワイドの製品販売網

Phenitec
For Further Growth Together



フェニテック セミコンダクター

**半導体受託専業(ファウンドリ)
ディスクリート、パワーデバイス
CMOSアナログプロセス**

※売上に占めるトレックスからの受託シェアは
15%程度

強み

- ・高品質を支える生産ノウハウ
- ・長期安定供給のJapanFab
- ・車載 IATF16949取得工場
- ・専門性の高い製造対応力
- ・オリジナルデバイスの開発力
- ・パワーデバイスの開発力

 
トレックス・
セミコンダクター
グループ

- ・顧客第一に徹した、小回りの利く対応力
- ・積極的なコラボレーションやM&Aによる協力関係の構築

**ファブレス&ファウンドリ
それぞれが本業を突き詰めたプロ集団となり、
相互補完でシナジーを発揮する。**

- 国内に東京本社を含む 8 拠点、海外に9つの拠点を設け、世界の需要に対応しています。



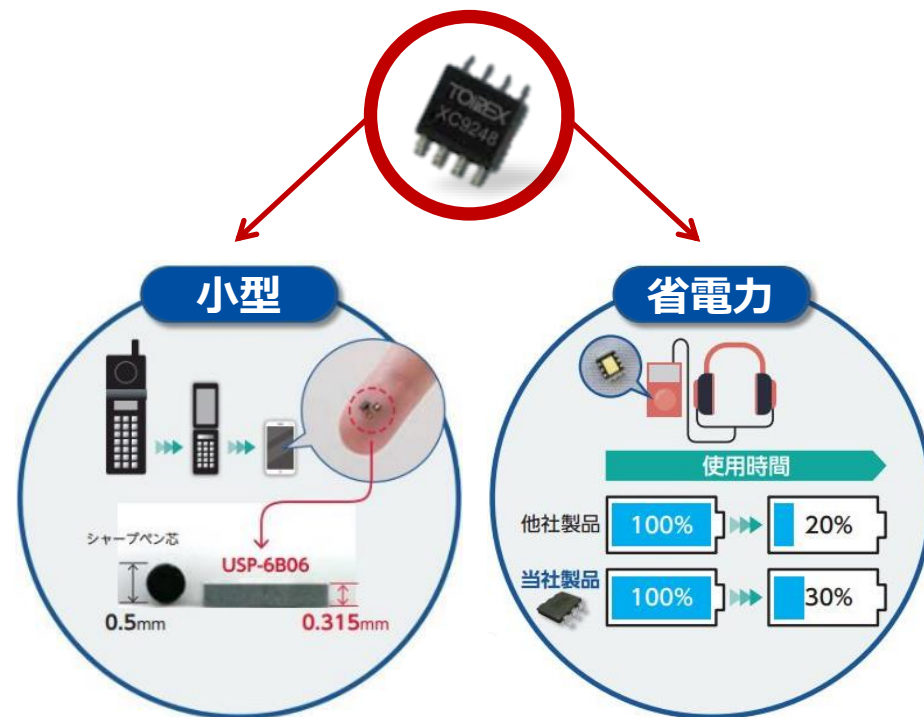
- 世界トップクラスの小型・省電力電源ICを開発・販売しています。

電源ICの役割



電子機器の様々な機能を動かすために
電圧を制御し安定供給する

TOIREXの電源IC



独自の技術で電子機器の
小型化、省電力化に貢献

	トレックス・セミコンダクター	フェニテックセミコンダクター
事業形態	ファブレス	ファウンドリ
主な製品	<p style="background-color: #FFD700; text-align: center; padding: 5px;">省エネに貢献するキーデバイスを提供</p> <p>電源IC</p>	<p>ディスクリート パワー半導体 (SiC、GaN、酸化ガリウム)</p>
今後の重点市場	<p>産業機器 5G、IoTモジュール 全固体電池モジュール</p> <p>車載機器 自動運転、ADAS、車載カメラ 電子ミラー他、様々なECU</p>	<p>産業機器 産業用ロボット、鉄道、インバータ 発電施設（風力・太陽光）、パワーコンディショナー</p> <p>車載機器 EV向けパワー半導体 電装品</p>



5G



IoT

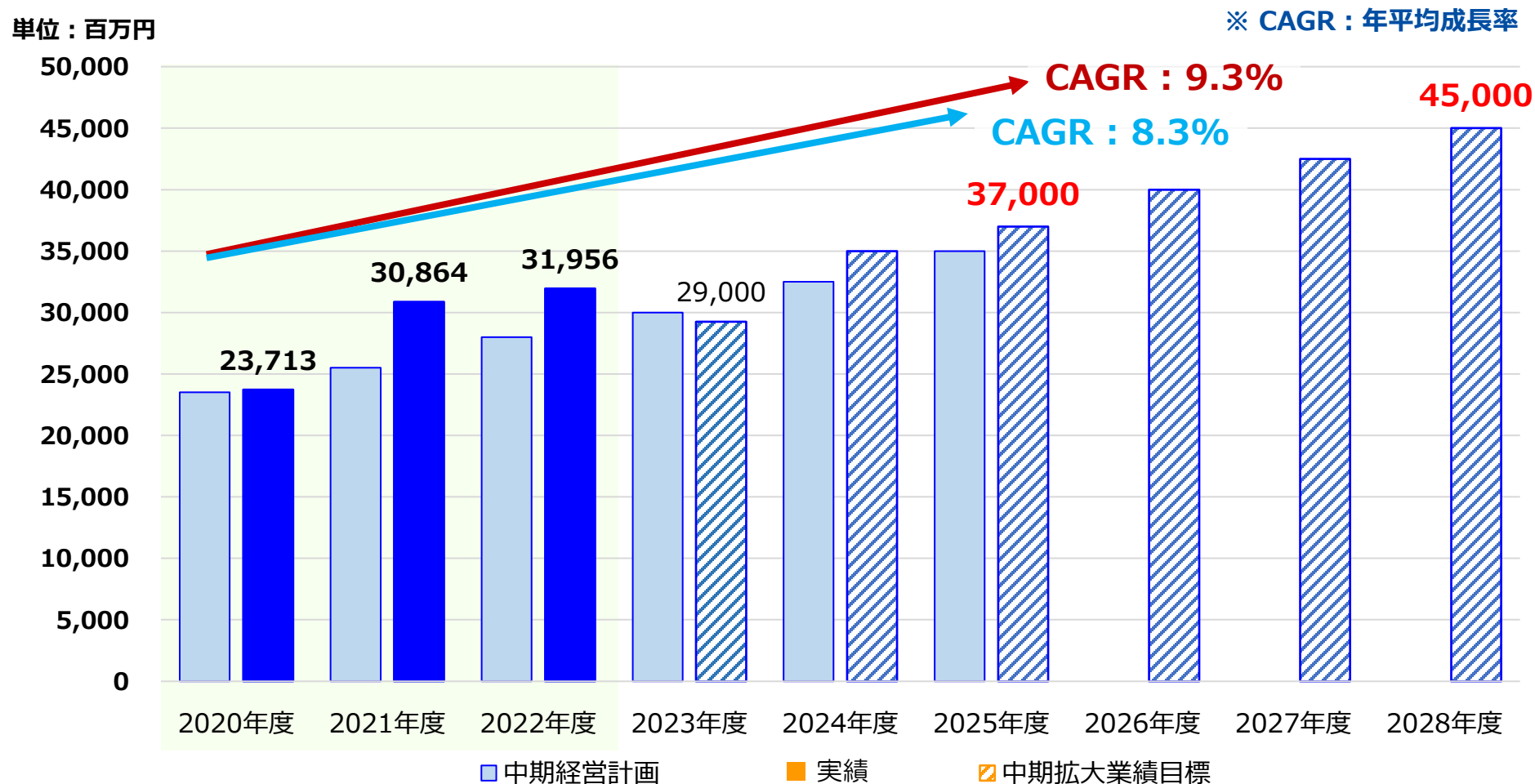


自動運転



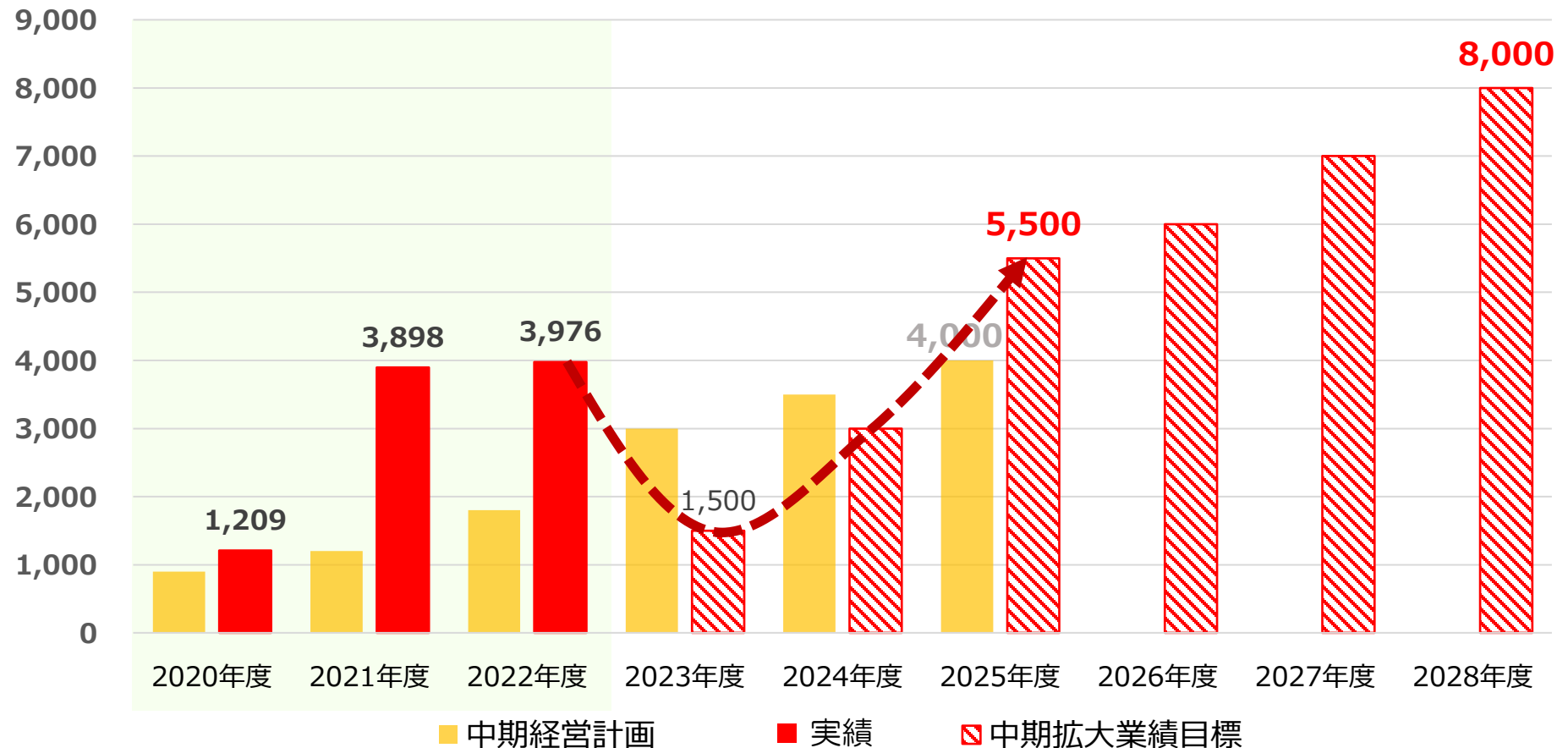
EV

- ・中期経営計画の2025年度の売上は350億円（CAGR※ 8.3%）
- ・拡大中期業績目標の2025年度の売上は**370億円**（**CAGR 9.3%**）
- ・2028年度の売上を**450億円**を目指す



- ・中期経営計画の2025年度の営業利益は40億円
- ・2022年度の営業利益は約40億円、23年度は一旦落ち込む
- ・2025年度計画は55億円、28年度には80億円を目指す

単位：百万円



Powerfully Small!

常に豊かな知性と感性を磨き、
市場に適応した価値ある製品を創出し、
豊かな社会の実現と
地球環境の保全に貢献するとともに、
私たちの事業に携わるすべての人々が
共に繁栄すること

